

# 京セラ株式会社 2018年3月期上期 決算説明会

(2017年10月31日実施)

代表取締役社長 谷本 秀夫 スピーチ

## <1・2. 2018年3月期上期 決算概要>

上期においては、情報通信、自動車関連並びに産業機械市場での旺盛な部品需要を背景に「産業・自動車用部品」や「電子デバイス」の売上が大幅に増加しました。また、新製品の投入及び積極的な拡販活動により「ドキュメントソリューション」の売上也拡大したことから、売上高は前年同期に比べ13%増加の7,383億円となり、上期としては過去最高となりました。

利益については増収及び原価低減に加え、前期に構造改革を実施し生産性向上に努めた結果、前年同期に比べ大幅に増加しました。営業利益は2倍の695億円となり、税引前四半期純利益は81%増加の878億円、当社株主に帰属する四半期純利益は70%増加の614億円となりました。

なお、上期の平均為替レートは対米ドルは前年同期に比べ6円円安の111円、対ユーロは8円円安の126円となりました。この結果、売上高は前年同期に比べ約240億円、税引前四半期純利益は約70億円押し上げられました。

## <3. 2018年3月期上期 事業セグメント別売上高>

こちらのスライドは事業セグメント別の売上高の状況です。「部品事業」及び「機器・システム事業」とともに増収となりました。

## <4. 2018年3月期上期 事業セグメント別事業利益>

事業利益については増収及び原価低減により、多くのセグメントで売上の伸び率を上回る大幅増益となりました。また、全ての「部品事業」及び「ドキュメントソリューション」では、2桁の事業利益率を達成しました。

それでは、各事業セグメントの状況について前年同期と比較し、ご説明します。

#### <5. 2018年3月期上期 事業セグメント別業績(1)>

まず、「産業・自動車用部品」ですが、旺盛な需要に加え、M&Aによる寄与もあり、機械工具の売上が増加しました。また、ディスプレイ及び半導体製造装置用部品の売上也増加したことから、当事業セグメントの売上高は前年同期に比べ22%増加しました。

事業利益は増収及び原価低減により2倍以上の伸びとなり、事業利益率は前年同期の5.9%から11.3%へと2桁へ向上しました。

次に「半導体関連部品」ですが、スマートフォン向けセラミックパッケージや通信インフラ向け有機パッケージの売上が増加したことにより8%の増収となりました。

事業利益は増収及び原価低減により84%の増益となり、事業利益率も前年同期の8.3%から14.1%へと2桁へ向上しました。

#### <6. 2018年3月期上期 事業セグメント別業績(2)>

「電子デバイス」はスマートフォン向けにコンデンサや水晶部品、コネクタの売上が増加したことに加え、産業機器向けにプリンティングデバイスの売上也伸びたことから、20%の増収となりました。

事業利益は増収及び原価低減により68%の増益となり、事業利益率も前年同期の11.4%から4ポイント向上し、15.9%となりました。

「コミュニケーション」は、ICTソリューション等を提供する情報通信サービス事業の売上が増加したことに加え、通信機器事業における国内向け携帯端末の販売が増加したことにより、9%の増収となりました。

事業利益は増収に加え、固定費の削減に努めた結果、70億円改善し黒字化しました。

### <7. 2018年3月期上期 事業セグメント別業績(3)>

「ドキュメントソリューション」は、新製品の投入及び積極的な拡販活動により販売台数が増加したことに加え、M&Aによる売上貢献もあり、17%の増収となりました。

事業利益は増収及びコスト低減に加え、為替の影響もあり、56%の増益となりました。また事業利益率は前年同期の8.7%から11.7%へと2桁へ向上しました。

最後に「生活・環境」ですが、ソーラーエネルギー事業において米国事業を縮小したことにより、当事業セグメントの売上高は減少しました。

事業利益は原価低減に努めた結果、改善したものの、減収及び研究開発費の増加を主因に事業損失となりました。

以上が当上期の決算概要です。続きまして、通期の業績予想についてご説明します。

### <8・9. 2018年3月期通期 業績予想>

上期の業績は好調な事業環境を背景に、「部品事業」を中心に想定を上回って推移しました。下期も主に産業機械や自動車関連市場向けに各種部品の需要増が見込まれます。また、為替レートも期初予想に比べ円安で推移していることから、通期の売上高及び利益は5月に公表しました予想を上回る見通しです。

売上高は前回予想を600億円上回り、過去最高となる1兆5,600億円、営業利益は150億円増加の1,350億円、税引前当期純利益は200億円増加の1,700

億円、当社株主に帰属する当期純利益は 140 億円増加の 1,190 億円を予想しています。

なお通期の為替レートは、対米ドルが 5 月予想の 108 円から 111 円、対ユーロが 115 円から 128 円となる見通しです。

#### <10. 2018 年 3 月期 事業セグメント別売上高予想>

#### <11. 2018 年 3 月期 事業セグメント別利益予想>

10 ページには事業セグメント別の売上高の予想を、11 ページには利益の予想を示しています。いずれも前期比では部品及び機器・システム事業ともに増収増益を予想しており、前回予想比では部品事業が大幅に増収増益となる見通しです。

#### <12. 2018 年 3 月期通期業績予想修正の主な要因>

業績予想修正の主な要因は上期実績の上ぶれです。

1 点目は好調な事業環境によるものです。スマートフォン市場や産業機械、自動車市場向けに部品の受注が想定を上回って推移しました。

2 点目は前期より積極的に進めてまいりました、生産能力の増強による効果です。コンデンサや半導体製造装置用部品などは、今期の旺盛な需要が見込まれていたため、前期より能力増強を進めてきました。のちほどご説明しますが、これらの部品については好調な需要が現在も続いており、当社はさらなる生産能力の拡大を進めています。

3 点目は全社で取り組んでいます原価低減や生産性向上による成果です。これにより、多くの事業部門で収益性の向上が図られています。

続きまして各事業セグメントの予想についてご説明します。

### ＜13. 2018年3月期通期 事業セグメント別業績予想（1）＞

まず「産業・自動車用部品」ですが、産業機械及び自動車関連市場向け部品などの需要の増加により、売上・利益ともに前期及び前回予想を上回る見通しです。

次に「半導体関連部品」ですが、スマートフォン向けセラミックパッケージや、通信インフラ向け有機パッケージの売上増により、売上・利益ともに前期及び前回予想を上回る見通しです。また売上の上方修正及び原価低減により、利益率もさらに向上する見通しです。

### ＜14. 2018年3月期通期 事業セグメント別業績予想（2）＞

「電子デバイス」は、スマートフォン向けコンデンサや水晶部品、コネクタの売上増に加え、産業機器向けプリンティングデバイスの需要増により、売上・利益ともに前期及び前回予想を上回る見通しです。

次に「コミュニケーション」ですが、前期比では、国内向け端末及び通信モジュールの売上増により増収を見込むものの、北米向け端末の売上減の影響等により、減益となる見通しです。また前回予想比では、北米向け端末の売上が期初予想を下回ることから、売上・利益ともに減少する見通しです。

### ＜15. 2018年3月期通期 事業セグメント別業績予想（3）＞

「ドキュメントソリューション」については、前期比では新製品の販売が好調に推移していることから、増収増益を見込んでいます。また前回予想比では原価低減及び円安効果により、利益は上回る見通しです。

最後に「生活・環境」ですが、ソーラーエネルギー事業の売上が期初予想を下回ることから、当事業セグメントの売上・利益は前期及び前回予想に比べ減少する見通しです。

以上が今期の業績予想の概要です。

続いて、今後の売上拡大に向けた取り組みについてご説明します。

#### <16. 売上拡大に向けた取り組み（1）生産能力の拡大①>

現在、部品事業は旺盛な需要環境にあり、当社では多くの部品において生産能力の増強を行っています。半導体製造装置においては、需要増に加え高性能化が進んでいます。エッチング装置ではプロセス温度の高温化、プラズマの強化が図られ、露光装置用部品では軽量化、高精度化が進むなど、製造装置の増加以上にファインセラミック部品のニーズが高まっています。

当社はこのような需要増に応えるため、国内外にて積極的な増産投資を行っています。本年4月には米国ワシントン工場に新棟を増設し、同工場での半導体製造装置用部品の生産能力を従来の約1.5倍に引き上げました。さらに来期以降も、現在の生産能力を上回る受注が見込まれることから、このたび鹿児島国分工場への新棟増設を決定しました。着工は11月、投資総額は生産設備を含め約56億円を計画しており、来年10月の稼働を予定しています。この新棟完成により、国分工場での同製品の生産能力は従来の約2倍となる見通しです。

#### <17. 売上拡大に向けた取り組み（1）生産能力の拡大②>

当社は部品事業だけでなく、機器事業においても生産能力の拡大に取り組んでいます。ドキュメントソリューション事業は現在好調に推移しており、さらなる売上拡大を図るため、トナーコンテナ及び感光体ドラムの生産能力の増強を進めるとともに、生産ラインの完全自動化を推進しています。

スライド左側の三重玉城にあるトナーコンテナ工場では、最新技術を導入し生産の完全自動化と省人化を徹底的に追求した生産ラインを実現しています。本年6月より稼働し、2020年には玉城工場全体のトナーコンテナの生産能力を現在の2倍以上に拡大させる計画です。

また複合機やプリンターの基幹部品である感光体ドラムについては、スライド右側に示しますとおり、来年5月の稼働を目指し、中国工場に新棟を建設しています。この新棟も完全自動化ラインを導入する予定であり、2020年には中国工場での同製品の生産能力を現在の2.5倍以上とする計画です。

#### <18. 売上拡大に向けた取り組み(2) M&Aによる事業領域の拡大①>

当社は売上拡大に向けて、M&Aによる事業領域の拡大も進めています。

まず機械工具事業においては、9月にリョービ株式会社様の電動工具事業の取得について基本合意を締結しました。同事業の取得は来年1月を予定しており、これにより次のスライドに記載のとおり、機械工具事業の多角化を推進してまいります。

#### <19. 売上拡大に向けた取り組み(2) M&Aによる事業領域の拡大②>

自動車関連市場向け切削工具を中心に展開している機械工具事業においては2011年に欧州を拠点とするユニメルコ社を買収し、これを機に建築用空圧工具事業に参入しました。また本年8月には、米国の空圧工具メーカーであるSENCO Holdings, Inc.を京セラグループに加え、さらに来年1月からは国内を中心に幅広い産業向けに展開しているリョービ株式会社様の電動工具事業が加わる予定です。

今後、切削工具から空圧・電動工具まで展開する総合工具メーカーとしてさらなる事業拡大を図ります。

#### <20. 売上拡大に向けた取り組み(2) M&Aによる事業領域の拡大③>

次に重点市場におけるM&Aの活用についてご説明します。

自動車関連市場での事業拡大については、グループを挙げて取り組んでいます。米国子会社のAVX Corporationは自動車用センサー事業の拡大を図るため、英国の電子部品メーカーであるTT Electronics PLCの輸送及びセンシングコントロール事業を10月に取得しました。同事業では、自動車の安全性と

快適性の向上をサポートする各種センサー、コントロールモジュール等の開発、製造、販売を行っています。この買収により、温度やポジション、スピード計測用センサーなどの製品ラインアップの拡充に加え、両社の販路活用による海外市場での売上拡大を見込んでいます。

#### <21. 売上拡大に向けた取り組み（2） M&Aによる事業領域の拡大④>

もう一つの重点市場である情報通信市場での売上拡大策として、ドキュメントソリューション事業において、プリンターや複合機などのハードから、文書関連のソリューションやアウトソーシングサービスまで幅広く展開するトータル・ドキュメント・ソリューション・プロバイダーを目指しています。

当社は 8 月に米国で ECM 事業及びドキュメント BPO 事業を提供する DataBank IMX, LLC を買収しました。病院や金融機関などの顧客基盤を有する同社をグループに加え、ECM 及びドキュメント BPO 事業と機器事業を融合させた新たなビジネスモデルを構築し、米国市場におけるサービス事業の強化を図ります。

以上が、売上拡大に向けた取り組みです。

#### <22. 経営方針>

本年 5 月に経営方針をご説明しましたが、その進捗についてご紹介します。スライド左側の「徹底した原価低減による既存事業の拡大」においては、「プロセス改革による原価低減」と「AI やロボット等の活用による生産性倍増」に取り組んでいます。生産性の向上において AI とロボットの活用は欠かすことができません。当社はこのたび、AI とロボットの活用を促進する目的で 2 つの拠点を開設しました。

AI については、9 月に「AI ラボ」を横浜に設立しました。各事業部門に AI を活用するツールを提供するほか、ビッグデータの解析や管理のノウハウを蓄積し、社内の様々な部門へと提供してまいります。



ロボットについては、10月に「ロボット活用センター」を大阪に設立しました。各事業部門の支援のために、ロボットの活用試験等を実施し、生産性向上に貢献してまいります。

今後、これらの拠点のノウハウをグループ内で共有することにより、生産性倍増の足掛かりとしてまいります。

またスライド右側の「社内外との連携強化による新規事業の創出」については「技術面での社内シナジーの強化」として、本年4月に「メディカル開発センター」を滋賀野洲工場内に新設しました。グループ内の医療・ヘルスケア関連のリソースを当センターに集約し、新規事業の早期創出を目指しています。従来の人工関節などの医療材料に留まらず、さまざまな電子部品や通信技術などのリソースを有している強みを活かし、より高度な医療・ヘルスケア向け新製品の研究開発を進めています。

下段の「外部リソースの活用」については、先程ご説明したM&Aに加え、他社との協業も積極的に行っています。東芝マテリアル株式会社様との窒化物セラミック部品の協業では、来期以降も好調な事業環境が予想される半導体製造装置市場を中心に、従来の技術では実現できなかった高機能部品を早期に投入できるよう開発に取り組んでいます。

### <23. 配当予想>

説明の最後に今期の配当についてご説明します。

当社は通期業績予想を踏まえ、今期中間配当金については前年同期に比べ10円増配の60円とさせていただきました。これに伴い、通期の配当予想についても従来予想の110円から120円へ上方修正しています。

当社は今後も利益の増加を図り、株主還元のためさらなる充実に努めてまいります。

#### <24. 売上高及び税引前利益の推移>

ただ今ご説明しました取り組みを進め、まずは今期、過去最高の売上高となる1兆5,600億円、税引前利益1,700億円の達成を図るとともに、目標としている2021年3月期売上高2兆円の達成に向けて、さらなる成長を目指してまいります。

以上